PEST AVAILABLE COPY

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003 年8 月28 日 (28.08.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/070623 A1

(51) 国際特許分類7:

B81B 1/00,

B81C 5/00, G01N 37/00, B01J 19/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP03/02066

(22) 国際出願日:

2003 年2 月25 日 (25.02.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-48580 2002 年2 月25 日 (25.02.2002) JP 特願2002-292978 2002 年10 月4 日 (04.10.2002) JP 特願2003-46414 2003 年2 月24 日 (24.02.2003) JP

特願2003-46414 2003 年2 月24 日 (24.02.2003) JP (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.)

[JP/JP]; 〒163-0449 東京都 新宿区 西新宿二丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 河添宏 (KAWA-ZOE,Hiroshi) [JP/JP]; 〒308-8521 茨城県 下館市 大字 小川1500番地 日立化成工業株式会社 総合研究所内 [Jp/JP]; 〒308-8521 茨城県 下館市 大字小川1500番地 日立化成工業株式会社 総合研究所 工業株式会社 総合研究所内 [Jp/JP]; 〒208-8521 茨城県 下館市 大字小川1500番地 日立化成工業株式会社 総合研究所内 [baraki (JP). 有家 茂晴

(ARIKE,Shigeharu) [JP/JP]; 〒308-8521 茨城県 下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社 総合研究所内 Ibaraki (JP).

- (74) 代理人: 三好 秀和 (MIYOSHI, Hidekazu); 〒105-0001 東京都 港区 虎ノ門一丁目2番3号 虎ノ門第一ビル9 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

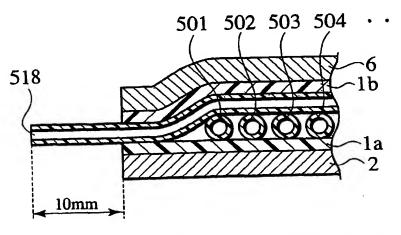
添付公開書類:

- -- 国際調査報告書
 - 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受 領の際には再公開される。

/毓葉有]

(54) Title: MICRO FLUID SYSTEM SUPPORT UNIT AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(54) 発明の名称: マイクロ流体システム用支持ユニット及びその製造方法



(57) Abstract: A micro fluid system support unit includes a first support body (2), a first adhesive layer (1a) arranged on the surface of the first support body (2), a first hollow filament group consisting of a plurality of hollow filaments (501 to 508) arranged with an arbitrary shape on the surface of the first adhesive layer (1a), a second hollow filament group consisting of a plurality of hollow filaments (511 to 518) arranged in the direction orthogonal to the first hollow filament group, a second adhesive layer (1b) arranged on the surface of the second hollow filament group, and a second

support body (6) arranged on the surface of the second adhesive layer (1b). The first and the second hollow filament group constitute a flow passage layer.

WO 03/070623 A1

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

- 1 -

5

明細書

マイクロ流体システム用支持ユニット及びその製造方法

技術分野

本発明は、支持体上に中空フィラメントを所定の形状に敷設固定したマイクロ流体システム用支持ユニットと その製造方法に関するものである。

背景技術

化学や生化学の分野ではマイクロ電子機械システム(MEMS: Micro Electro Mechanical System)技術を応用した反応系や分析装置の小型化に関する研究が進められている。従来の研究開発では、構成要素の一つとなるマイクロモータ、マイクロポンプの単一機能を有するマイクロ化した機械要素(マイクロマシン)がある。

目的の化学反応や化学分析を行うためには、マイクロマシンなどの各種部品を複数組み合わせてシステム化する必要がある。一般にそれらのシステムの完成形は、マイクロリアクター(Micro Reactor System)、マイクロ化学分析システム(μTAS:Micro Total Analysis System)などと呼称されている。通常、マイクロマシンは半導体製造プロセスを適用してシリコンチップ上に形成する。複数の要素を一つのチップに形成(集積)し、シ

発明の開示

本発明は、上記課題を解決するためになされたものである。即ち、本発明の目的は、製造が容易で、かつ反応や分析のステップ数や量を制限しない c m単位の長い距離のマイクロ流体システム用支持ユニットを提供することである。

本発明の他の目的は、複雑な流体回路であっても場所を要しない小型マイクロ流体システム用支持ユニットを 提供することである。

本発明の更に他の目的は、複雑な流体回路を形成できるマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法を提供することである。

クロ流体システム用支持ユニットを提供することが出来る。更に、本発明の第1の特徴によれば、複雑な流体回路であっても場所を要しない小型マイクロ流体システム用支持ユニットを提供することが出来るため、マイクロ流体システム自体のコンパクト化を図ることも出来る。

又、本発明の第2の特徴は、(a)第一の支持体と、 (b) この第一の支持体の表面に設けられた第一の接着 剤層と、(c)第一の接着剤層の表面に任意の形状に敷 設され、それぞれがマイクロ流体システムの複数の流路 層として機能する複数の中空フィラメントからなる第一 の中空フィラメント群とを備えるマイクロ流体システム 用支持ユニットであることを要旨とする。本発明の第 2 の特徴においては、複数の中空フィラメントからなる第 一の中空フィラメント群に、これらに交差する複数の中 空フィラメントからなる第二の中空フィラメント群を立 体的に敷設することが出来るため、精度が良く、製造が 容易で、かつ反応や分析のステップ数や量を制限しない cm単位の長い距離のマイクロ流体システム用支持ユニ ットを提供することが出来る。更に本発明の第1の特徴 によれば、複雑な流体回路であっても場所を要しない小 型マイクロ流体システム用支持ユニットを提供すること が出来るため、マイクロ流体システム自体のコンパクト 化を図ることも出来る。

本発明の第3の特徴は、(a)第一の支持体の表面に、 第一の接着剤層を形成するステップと、(b) この第一

図面の簡単な説明

図1Aは、本発明の第1の実施例に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの断面図で、図1Bは、IA-IA線矢印方向から見た断面図が図1Aに対応する平面

図である。

図2は、本発明の第1の実施例に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法を説明する工程断面図(その1)である。

図3Aは、本発明の第1の実施例に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法を説明する工程断面図(その2)で、図3Bは、IIA-IIA線矢印方向から見た断面図が図3Aに対応する平面図である。

図4Aは、本発明の第1の実施例に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法を説明する工程断面図(その3)で、図4Bは、NA-NA線矢印方向から見た断面図が図4Aに対応する平面図である。

図 5 A は、本発明の第 1 の実施例に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法を説明する工程断面図(その 4)で、図 5 B は、V A - V A 線矢印方向から見た断面図が図 5 A に対応する平面図である。

図 6 A は、本発明の第 1 の実施例に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法を説明する工程断面図(その 5)で、図 6 B は、VI A - VI A 線矢印方向から見た断面図が図 6 A に対応する平面図である。

図7Aは、本発明の第1の実施例に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法を説明する工程断面図(その 6)で、図7Bは、WA-WA線矢印方向から見た断面図が図7Aに対応する平面図である。

図8Aは、本発明の第2の実施例に係る中継部を備え

るマイクロ流体システム用支持ユニットの鳥瞰図で、図 8 B は、図 8 A の W B - W B 線方向の断面図である。

図9Aは、本発明のその他の実施例に係るマイクロ流体システム用支持ユニット用中空フィラメントの構造を説明する鳥瞰図(その1)であり、図9Bは、本発明のその他の実施例に係るマイクロ流体システム用支持ユニット用中空フィラメントの構造を説明する鳥瞰図(その2)である。

図10は、本発明のその他の実施例に係る中継部を備 えるマイクロ流体システム用支持ユニットの断面図であ る。

図11Aは、図11Cに示す本発明の更に他の実施例に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの平面図の XIA-XIA線矢印方向から見た断面図、図11Bは、 図11Cに示す平面図のXIB-XIB線矢印方向から 見た断面図である。

図12は、図11に示した本発明の更に他の実施例に 係るマイクロ流体システム用支持ユニットの鳥瞰図であ る。

図13は、本発明の更に他の実施例に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの変形例を示す鳥瞰図である。

発明を実施するための最良の形態

図面を参照して、本発明の実施例を説明する。以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は

類似の符号で表している。ただし、図面は模式的なものであり、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは異なる。したがって、具体的な厚みや寸法は以下の説明を照らし合わせて判断するべきものである。又、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。

(第1の実施例)

(マイクロ流体システム用支持ユニット)

図1に示すように、本発明の第1の実施例に係るマイ クロ流体システム用支持ユニットは、第一の支持体2と、 この第一の支持体2の表面に設けられた第一の接着剤層 1 aと、第一の接着剤層1aの表面に任意の形状に敷設 された複数の中空フィラメント501,502,503,, 508からなる第一の中空フィラメント群と、 この第一の中空フィラメント群に交差する方向に敷設さ れた複数の中空フィラメント 5 1 1 , 5 1 2 , 5 1 3 ,, 5 1 8 からなる第二の中空フィラメント群と、 この第二の中空フィラメント群の表面に設けられた第二 の接着剤層1bと、第二の接着剤層1bの表面に設けら れた第二の支持体 6 とを備える。複数の中空フィラメン ト 5 0 1 , 5 0 2 , 5 0 3 , ・・・・・ , 5 0 8 からなる第 一の中空フィラメント群、及び複数の中空フィラメント 5 1 1 , 5 1 2 , 5 1 3 , ・・・・ , 5 1 8 からなる第二 の中空フィラメント群は、それぞれ本発明の第1の実施 例に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの薬液の 流路層を構成している。

複数の中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 及び 5 1 1 ~ 5 1 8 の内径及び外径は目的に応じて選択すれば良いが、 ミリリットル (mL) ~マイクロリットル (μ L) 単位 の流体を流すことから、内径は、φ0.05 mm~0. 5 mm程度のものが好ましい。この様な径の中空フィラ メント 5 0 1 ~ 5 0 8 及び 5 1 1 ~ 5 1 8 を作製する場 合は、ポリイミド(PI)、ポリエーテルエーテルケト ン (PEEK)、ポリエーテルイミド(PEI)、ポリ フェニレンサルファイド(PPS)、4フッ化エチレン パーフルオロアルコキシエチレン共重合体 (PFA) などの材質が特に適している。 Φ 0 . 0 5 m m 以下の内 径にすると、中空フィラメント501~508及び51 1~518の内壁面と流体との界面抵抗の影響が無視で きなくなる。一方、 φ 0 . 5 m m より大きい内径では流 体を連続的に流すためには高圧が必要となり他の部品へ の負担が増え、又流体中への気泡の混入などが生じてし まう。複数の中空フィラメント501~508からなる 第一の中空フィラメント群、及び複数の中空フィラメン ト511~518からなる第二の中空フィラメント群に 流している流体に化学反応を生じさせる場合は、中空フ ィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 , 5 1 1 ~ 5 1 8 は耐薬品性 を備えるものが良い。又、中空フィラメント501~5 08,511~518に流している流体に光を照射し、 光化学反応を生じさせたり、分光分析をする場合は、中 Ø

空フィラメント501~508,511~518に光透過性があると良い。光透過率は目的に応じた値で良いが、目的波長において80%以上であることが好ましく、更に、90%以上あれば最適である。即ち、図9Aに示明ない、所定箇所の第二の支持体6、第二の接着剤配1 b、及び中空フィラメント58が透明であると良い。

中空フィラメント501~508,511~518を第一の支持体2に固定することは、フリーの状態々のことは、フリーのと比較して、周囲の温度・電場・磁場など様ののにありの温度・対力がある。という析を行う際においてはいて、一つのというのである。という利点もある。

マ、化学分析を行う場合、複数の中空フィラメント5 01~508,511~518を有していることが作うの場合、第一の中空フィラとの中空フィラスト501~501~50 分率を構成する複数の中空フィラメント50 8は、同時に分析を開始した時、ほぼ同かに分析で りないないう観点からにいてで あることが求められる。同様に、第二の中空フィラメント511~518 も等長であることが求められる。 つまり、 試料の流入部から流出部まで外部から受けるエネルギー量が均一量とり、 更に他の中空フィラメントが受けるエネルギー量ともほとんど差がないことが重要である。 この様な観点から、中空フィラメント501~508,511~518 に伝わる熱の分布が均一になるように中空フィラメト501~508,511~518が2枚以上の支持体間に挟まれていることが好ましい。

又、第一の中空フィラメント群を構成する複数の中空フィラメント501~508及び第二の中空フィラメント511~518は、それぞれ互いに等間隔に配列されていることががまましい。又、第一の中空フィラメント群を構成する複数の中空フィラメント511~518の管の厚みは均一である方が良い。

ーメチルペンテン(TPX)、ポリメチル、PEEK、PI、PEI、4クリス、PEEK、PI、BEI、4クリス、PEEK、PI、樹脂(FEP)、インカースッ化プロピレンサー(FEP)、FETには一つカー・ボーンが、ボリステロンが、ボースを関係をして、デアロンが、ボースを関係をして、アンカーが、ボースを関係をして、アンカーが、アンカーが、アンカーが、アンカーが、アンカーが、アンカーが、アンカーが、アンカーが、アンカーが、アンカーが、アンカーが、アンカーが、アンカーが、アンカーが、アンカーが、アンカーが、カーボンなどの無機材質がある。

板、銅(Cu)板、ステンレス板、チタン(Ti)板な どの金属製の板を選定する。第一の支持体2の板厚は更 に厚い方が好ましく、特には 0.5mm以上であること が望ましい。又、第一の支持体2に光透過性を求める場 合は、ガラス、石英板など透明無機材料の板や、ポリカ ーポネートやアクリルなど透明有機材料の板やフィルム を選定する。第一の支持体2の板厚(フィルム厚)は薄 い方が好ましく、特には0.5mm以下であることが望 ましい。更に、第一の支持体2の表面に銅等の金属パタ ーンをエッチングやめっきで形成したいわゆるフレキシ ブル回路基板やプリント回路基板を用いても良い。この ことで、マイクロマシン、発熱素子、圧電素子、温度・ 圧力・歪み・振動・電圧・磁界など各種のセンサーや抵 抗・コンデンサ・コイル・トランジスタやICなどの電 子部品、更に半導体レーザ(LD)、発光ダイオード (LED)、及びフォトダイオード (PD) などの光部 品など、様々な部品や素子を実装する端子や回路を形成 でき、システム化が容易になる。

第一の支持体2の表面に形成する第一の接着剤層1 a は、感圧性や感光性を備える接着剤が好ましい。これ着性の材料は、圧力や光などを印加することで粘着性やお発現させるので、中空フィラメント(中空キャ剤では、高分子量合成ゴムの接着剤としては、例えば、ト

ーネックス社製のビスタネックスMML-120の様な ポリイソブチレンや、日本ゼオン社製のニポールN14 3 2 等のアクリロニトリルブタジエンゴムや、デュポン 社製のハイパロン20の様なクロルスルホン化ポリエチ レン等を用いることが出来る。この場合は、これら材料 を溶剤に溶解して第一の支持体2に直接塗布乾燥して第 一の接着剤層1aを形成することが出来る。更に、必要 に応じてこれら材料に架橋剤を配合することも出来る。 又、日東電工社製No.500やスリーエム社製のA-1 0 、 A - 2 0 、 A - 3 0 等 の ア ク リ ル 樹 脂 系 の 両 面 粘 着 テープ等も使用できる。シリコーン樹脂系の接着剤とし ては、高分子量のポリジメチルシロキサン又はポリメチ ルフェニルシロキサンからなり末端にシラノール基を有 したシリコーンゴムと、メチルシリコーンレジン又はメ チルフェニルシリコーンといったシリコーンレジンとを 主成分としたシリコーン接着剤が適している。凝集力を 制御するため各種の架橋を行っても良い。例えば、シラ ンの付加反応、アルコキシ縮合反応、アセトキシ縮合反 応、過酸化物などによるラジカル反応などにより架橋を 行うことが出来る。この様な接着剤として市販のもので は、YR3286(GE東芝シリコーン株式会社製、商 品名)やTSR1521(GE東芝シリコーン株式会社 製、商品名)、 D K Q 9 - 9 0 0 9 (ダウコーニング社 製、商品名)などがある。感光性接着剤としては、例え ば、プリント基板のエッチングレジストとして使用され とう性付与材の使用も好適な組み合わせであり、その例 としてはブタジェンアクリロニトリルゴム、天然ゴム、 アクリルゴム、SBR、カルボン酸変性プタジェンアク リロニトリルゴム、カルポン酸変性アクリルゴム、架橋 NBR粒子、カルボン酸変性架橋NBR粒子等が挙げら れる。この様な種々の樹脂成分を加えることで光硬化性、 熱硬化性という基本性能を保持したまま硬化物に色々な 性質を付与することが可能になる。例えばエポキシ樹脂 やフェノール樹脂との組み合わせによって硬化物に良好 な電気絶縁性を付与することが可能になる。ゴム成分を 配合した時には硬化物に強靭な性質を与えると共に、酸 化性薬液による表面処理によって硬化物表面の粗化を簡 単に行うことが可能になる。又、通常使用される添加剤 (重合安定剤、レベリング剤、顔料、染料等)を添加し ても良い。又フィラーを配合することもなんら差し支え ない。フィラーとしてはシリカ、溶融シリカ、タルク、 アルミナ、水和アルミナ、硫酸バリウム、水酸化カルシ ウム、エーロジル、炭酸カルシウム等の無機微粒子、粉 末状エポキシ樹脂、粉末状ポリイミド粒子等の有機微粒 子、粉末状ポリテトラフロロエチレン粒子等が挙げられ る。これらのフィラーには予めカップリング処理を施し てあっても良い。これらの分散はニーダー、ボールミル、 ビーズミル、3本ロール等既知の混練方法によって達成 される。この様な感光性樹脂の形成方法は、液状の樹脂 をロールコート、カーテンコート、ディプコート等の方

法で塗布する方式や、絶縁樹脂をキャリアフィルム上でフィルム化してラミネートで張合わせる方式を用いることが出来る。具体的には、日立化成工業(株)製のフォトピアフィルムBF-8000等がある。

第二の接着剤層1bは、第一の接着剤層1aで示した 各種の材料が使用できる。

(マイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法)

次に、本発明の第1の実施例に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法について図2~図8を用いて説明する。

(a)まず、図2に示すように、第一の支持体2の表面に、第一の支持体2と同一形状で、にぼぼ図3にに、第一の接着剤層1aの表面の周辺のを形成は、第一の接着剤層1aの表面の周辺のを第一の接着剤層1aの表面の様な離形層3a、3b、3c、3dを第一の法のの様の表面の形に、前の表面の形に、前の表面の形に、前の表面の形に、前の表面の形に、前の表面の形に、前の表面の形でのの表面の形でのがある。次には、第一の表面の形でのの表面の形で、前の表面の形で、前の表面の形で、がある。次に、4dは、10の前のでのがでは、4つの離形層3a、4b、4c、4dは、10の近傍の位置に形成する。

(b) 次に、図4に示すように、第一の接着剤層1 a が形成された第一の支持体2の表面に、複数の中空ライントがいるが形層3 d に向かう垂直なる第一の中でラインの中の方向に、変数の中でラスを強いの中でランメでの関系を数でである。際には1 を 2 0 0 1 - 5 9 9 1 0 5 0 年報である。 関係ののには 3 4 6 号公報に 対 る 表 置 は 布 線 時 に て の に 現 る 表 置 は 布 線 時 に 、 荷 重 の 印加として 3 2 号公報に 開示されている 装置は、 荷 重 の 印加として 2 2 号公報に 開示されている 装置は、 荷 重 の 印加とし

ザ光の照射が可能である。)。NC布線機61は、数値別問題音波振動と荷重の出力制御が可能であってとにおり、複数の中空スメント501~50%である。具体的であるがられる。対象機61を第一の対象機61を対し、水平に移動の中空スト501~50%がらなる。対象である。対象機61を対して対し、水平に移動をがらいてでである。対象でである。対象のででである。

(c) 次に、図 5 に示すように、複数の中空フィラメ ント511~518からなる第二の中空フィラメント群 を、すでに敷設された複数の中空フィラメント501~ 5 0 8 からなる第一の中空フィラメント群に交差するよ うに、離形層3aから離形層3cに向かう方向に敷設す る。この敷設の際には、図5Aに示すようにNC布線機 6 1 を用いる。複数の中空フィラメント 5 1 1 ~ 5 1 8 からなる第二の中空フィラメント群の敷設パターンを精 密に制御できる。具体的には、NC布線機61を第一の 支持体2に対し、水平に移動させながら、複数の中空フ ィラメント511~518からなる第二の中空フィラメ ント群に荷重及び超音波による振動をかける。ただし、 この N C 布線機 6 1 は中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 からなる第一の中空フィラメント群と中空フィラメント 5 1 1 ~ 5 1 8 からなる第二の中空フィラメント群とが 交差する部分では荷重と超音波振動は止まるように設定 する。第一の中空フィラメント群と第二の中空フィラメ ント群との交差部の近傍で、荷重及び/又は超音波振動 を止めることで、中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 、 5 1 1 ~ 5 1 8 への応力を低減し、中空フィラメント 5 0 1~508、511~518の破損を防ぐことが出来る。 (d) 次に、図 6 に示すように、すでに敷設された複 数の中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 からなる第一の中 空フィラメント群、及び複数の中空フィラメント511 ~518からなる第二の中空フィラメント群を覆うよう に、第一の支持体2の同一形状で、ほぼ同一サイズの第 二の接着剤層 1 b を形成する。更に、第一の支持体 2 の 同一形状で、同一サイズの第二の支持体6を用意し、第 二の接着剤層1bの上に、第二の支持体6を接着(ラミ ネート)する。第二の支持体6をラミネートするには各 種方法が考えられる。この時に第二の支持体 6 が網目状 又は多孔性のフィルムの場合は、僅かの圧力をかけるこ とで界面に抱き込まれる空気等もなく保護フィルムを第 二の接着剤層1bに密着することが出来る。しかし、第 二の支持体 6 が 均 一 な フィ ル ム の 場 合 は 、 残 存 気 泡 は 避 けられない。この場合は、高圧でプレスする方法も考え られるが、中空フィラメント501~508,511~ 5 1 8 に大きな力が加わり中空部分の変形が生じる。更 に、第一の中空フィラメント群と第二の中空フィラメン ト群との交差部で局所的に大きな力がかかり破損してし まう等の問題がある。この様な場合は、真空ラミネート

装置を用いて、第二の支持体 6 が第二の接着剤層 1 bに密着する前に真空状態にし、その後低圧で圧着することで、界面に抱き込まれる空気もなく中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8, 5 1 1 ~ 5 1 8 に大きな応力が残存せず破損もないため好ましい。

(e) その後、図7Bの点線で示す所望の形状の切断 線7に沿って、加工切断する。第二の支持体6をラミネ ートした後に、所望の形状にマイクロ流体システム用支 持ユニットを加工する方法としては、カッターによる切 断や、所望の形に予め作製した金属製の刃型を押し当て て切断加工する等の方法がある。しかし、カッターでは 自動化に難があり、刃型は治工具の作製に手間がかかる ため、NC駆動のレーザ加工機の方がデータの準備のみ で作業できるため好ましい。又、レーザ加工機において も、切断専用の出力の大きな加工機よりも、プリント基 板用の小径穴あけ用途のレーザ穴あけ機が好ましい。プ リント基板用のレーザ穴あけ機は、単位時間当りのエネ ルギー出力が大きく同一の場所を複数のショット数で穴 あけし、穴径の半分程度づつ移動させてゆく方式であり、 レーザの焼け焦げが非常に少なく好ましい。切断線7は、 図7 B に示すように、予めスリット4 a, 4 b, 4 c, 4 d を入れておいた位置 4 a に重なる様に加工切断する。 図7Aに示すように、予めスリット4a,4b,4c, 4 d を入れておくことにより、中空フィラメント 5 1 8 の端部近傍において、第一の接着剤層1aと第二の接着

剤層1bが、自動的に剥離してくる。図示を省略してい るが、他の中空フィラメント501~508、511, 5 1 2 , 5 1 3 , ・・・・・ , 5 1 7 の端部も同様に、第一 の接着剤層1aと第二の接着剤層1bとが自動的に剥離 する。第一の接着剤層1aに複数の中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 からなる第一の中空フィラメント群、及び 複数の中空フィラメント511~518からなる第二の 中空フィラメント群を敷設し、その後に第二の接着剤層 1 b を介して第二の支持体 6 を張合わせた構造では、複 数の中空フィラメント501~508,511~518 の端部を露出する工程が煩雑となる。このため、不要と なって最後に除去される部分と、第一の支持体2として 残存する部分の境界線となるところに予めスリット4a, 4 b , 4 c , 4 d を設けておけば、中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 , 5 1 1 ~ 5 1 8 の端部を露出する処理が 容易になる。

(f)図7Bの点線で示す切断線7に沿って切断加工した後、中空フィラメント501~508の端部付近に配置された離形層3b及び離形層3d、更に、中空フィラメント511~518の端部付近に配置された離形層3a及び離形層3cを除去すれば、図1に示すマイクロ流体システム用支持ユニットが完成する。

上記のように、不要となって最後に除去される第一の支持体2の端部の表面に、図4に示すように、離形層3a,3b,3c,3dを設けておけば、マイクロ流体シ

ステム用支持ユニットの端部から複数の中空フィラメン ト501~508からなる第一の中空フィラメント群、 及び複数の中空フィラメント511~518からなる第 二の中空フィラメント群をそれぞれ取り出す処理を更に 容易に行うことが出来る。しかし、中空フィラメント5 0 1 ~ 5 0 8 、 5 1 1 ~ 5 1 8 は、露出する部分の長さ について注意する必要がある。中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 、 5 1 1 ~ 5 1 8 の露出しない部分は固定され ており、中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 、 5 1 1 ~ 5 18中の流体に対し、温度、流速分布、泳動速度分布及 び印加電圧等の因子を制御し易い。一方、中空フィラメ ント 5 0 1 ~ 5 0 8 、 5 1 1 ~ 5 1 8 の露出する部分は、 固定されず自由な状態であるので、前述の各因子を制御 することは難しいからである。又、中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 、 5 1 1 ~ 5 1 8 の露出する部分は、取り 扱い不注意等による折損を生じ易くなる。したがって、 露出させる長さは可能な限り短くすることが重要であり、 少なくとも露出させる部分の長さは、露出させない部分 の長さより短くすることが望ましい。

又、本発明の第1の実施例に係るマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法においては、中空の部材 (中空フィラメント) 501~508、511~518 を用いているので、設計や製造には相応の工夫が必要が されている。上記した第一の中空フィラメント群と第二 の中空フィラメント群との交差部の敷設条件の他に、保

(第2の実施例)

本発明の第2の実施例に係るマイクロ流体システム用支持ユニットは、図8に示すように、第一の接着剤層1a、第二の接着剤層1b、及び第二の支持体6を壁部とする中継部8を備える点が図1に示した本発明の第1の実施例に係るマイクロ流体システム用支持ユニットと異なり、他は本発明の第1の実施例と同様であるので重複した記載は省略する。

中継部8は、図8に示すように、第一の接着剤層1 a

と第二の接着剤層1bの間から中空フィラメント58を露出する構造になっている。露出した中空フィカメ、流体を排出する。中継部8の形状やサイズが体を混合、又は分岐させる。中継部8の形状やサイズが流体の流量に応じて決めれば良い。例えば、2~3本流流体のなり200μmの中空フィラメント58を保持する第一の接着剤層1bの厚さの合計が200μmの場合、中継部8はφ2mm~φ7mm程度の円柱形状で良い。

第二の支持体6を中継部8の一部とする方法としては、第二の支持体6を第二の接着剤層1bを接着した後、第二の支持体6に中継部8の一部となる形状に加工を施す工程がある。この場合は、注射針等のニードルで第二の支持体6を突き刺す方法等が適する。

又、他の方法としては、第一の接着剤層1aと第二の接着剤層1bに中継部8を形成する際、同時に第二の支持体6にも中継部8の一部となる形状に加工を施す方法がある。この場合は、前述のレーザで一括して加工をする方法等が適する。

更に、他の方法としては、第二の支持体 6 に予め中継部 8 の一部となる形状に加工を施しておき、これを第二の接着剤層 1 bに接着する方法がある。第二の支持体 6 に施す加工法としてはドリル加工、パンチング、及びレーザ加工等がある。

本発明の第2の実施例に係るマイクロ流体システム用支持ユニットによれば、中継部8を備えることによって、中空フィラメント58を流れる流体を混合又は分岐させることが出来る。更に、第二の支持体6を中継部8の一部にすることで、中継部8を開いた構造に出来るので、外部から中継部に新たな流体を注入する、又は中継部8にある流体を外部に取り出すことが出来る。

(実施例1)

第一の支持体 2 に厚さ 7 5 μmのデュポン社製カプト

ン300Hを用い、その表面に、図2に示すように、第 一の接着剤層1αとして、厚さ250μmで、室温で粘 着性であるスリーエム社製VBH A-10フィルムを ロールラミネートする。この第一の支持体2の所望の位 置に、図3に示すように、離形層3 a, 3 b, 3 c, 3 dとして片面離形紙を離形面が接着剤面が密着する様に 設ける。更に、図4に示すように、カッターで、第一の 支持体 2 の所望の位置に、スリット 4 a, 4 b, 4 c, 4 d を入れる。これに図 5 A に示すように、超音波振動 と荷重の出力制御が可能でNC制御でX-Yテーブルを 可動できるNC布線機61を用い、仁礼工業株式会社の 高機能エンプラチューブ (材質: PEEK、内径0.2 mm、外形 0 . 4 mm) 6 2 からなる中空 フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 , 5 1 1 ~ 5 1 8 を敷設する。敷設する 中空フィラメント501~508,511~518には、 荷重80gと周波数30kHzの超音波による振動をか ける。図5Bに示すように、中空フィラメント501~ 5 0 8 , 5 1 1 ~ 5 1 8 の敷設は、半径 5 mmの円弧状 に行い、交差する部分も設ける。その交差する部分の近 傍では、荷重と超音波振動を止めることとする。第二の 支持体6として、デュポン社製カプトン300Hの表面 にスリーエム社製VBH A-10フィルムをロールラ ミネートしたものを用い、図6に示すように、真空ラミ ネートで複数の中空フィラメント511~518からな る第二の中空フィラメント群を敷設した表面にラミネー

トする。その後の外形加工では、プリント基板用の小径 穴あけ用途のレーザ穴あけ機を用い、パルス幅 5 m s、 ショット数 4 ショットでφ 0 . 2 m m の穴を 0 . 1 m m 間隔で移動させて、図7に示す所望の切断線7に沿って、 幅広の十字の形に加工切断する。この時、 0 . 4 m m ピ ッチで8本まとめてフラットケーブル状になる部分で予 めスリット4 a, 4 b, 4 c, 4 d を入れておいた部分 と重なる様に加工する。その後、中空フィラメント 5 0 1~508,511~518の端部付近の第一の支持体 2 に離形層 3 a , 3 b , 3 c , 3 d を貼り付けてある部 分は容易に除去できる。そして、8本の全長20cmの 中空フィラメント501~508からなる第一の中空フ ィラメント群、及び8本の全長20cmの中空フィラメ ント511~518からなる第二の中空フィラメント群 を、それぞれの端部の10mmの長さを露出させた形状 でマイクロ流体システム用支持ユニットを作製する。敷 設部分全般、特に交差する部分で中空フィラメントの破 損はない。

この結果、複数の中空フィラメント501~508からなる第一の中空フィラメント群、及び複数の中空フィラメント群、及び複数の中空フィラメント群で形成した流路の位置ばらつきは、設計図面に対し、土10μm以内に収まる。マイクロ流体システム用支持ユニットを温度調節器内に入れ、80℃に保ち、液状の着色インクを一方の端から流入し、流出までの時間をス

トップウォッチ等の計測機器で計測した場合、8本ともほぼ同じタイミング(±1秒以下)で他端から流出する。

(実施例2)

第一の支持体2に厚さ0.5mmのアルミ板を用い、 図2に示すように、その表面に厚さ100μmの第一の 接着剤層1aとして非粘着型感圧接着剤ダウコーニング アジア社製のS9009をロールラミネートする。又、 図3に示すように、中空フィラメントの端部付近の表面 で不要となる部分に、粘着性のないフィルムとして片面 離形紙からなる離形層3a,3b,3c,3dを離形面 が接着剤面に密着する様に設ける。これに、図4及び図 5 に示すように、超音波振動と荷重の出力制御が可能で N C 制 御 で X - Y テーブルを 可動 で きる N C 布 線 機 6 1 を用い、ハギテック社のガラスチューブESG- 2 径0.8mm外径1mm)を敷設する。敷設する中空フ ィラメント501~508、511~518には、荷重 1 0 0 g と周波数 2 0 k H z の超音波による振動をかけ る。図5 Bに示すように、中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 、 5 1 1 ~ 5 1 8 の 敷 設 は 、 半 径 1 0 m m の 円 弧 状 に行い、交差する部分も設ける。その交差する部分の近 傍では、荷重と超音波振動を止めることとする。第二の 支持体6には、フィルム支持体と同じデュポン社製カプ トン200Hを用い、図6に示すように、真空ラミネー トを用いて中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 、 5 1 1 ~

518を施設した支持ユニット上にラミネートする。そ の際、流入部、流出部、及び交差部の中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 、 5 1 1 ~ 5 1 8 近傍に温度測定用の熱 電対を埋め込む。その後の、図7に示す外形加工では、 プリント基板用の外形加工機を用いて所望の形に切断す る。この時、1mmピッチで12本まとめてフラットケ ーブル状になる部分で予めスリット4 a , 4 b , 4 c , 4 d を入れておいた部分と重なる様に加工する。その後、 複数の中空フィラメント501~508、511~51 8の端部付近の支持体に粘着性のないフィルムを貼り付 けてある部分は容易に除去でき、12本の全長40cm の中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 、 5 1 1 ~ 5 1 8 を 5 0 mmの長さを露出させた形状のマイクロ流体システ ム用支持ユニットを作製できる。中空フィラメント 5 0 1 ~ 5 0 8 、 5 1 1 ~ 5 1 8 で形成した流路の位置ばら つきは設計図面に対し、±20μm以内に収まる。敷設 部分全般、特に交差配線部分で中空フィラメント501 ~ 5 0 8 、 5 1 1 ~ 5 1 8 の破損はない。

共立電子産業製のフィルムヒートFTH-40をアルミ板裏面の全面に貼り付け90℃に設定する。約20℃の水を一方の端から流入し、他端から流出した水の温度を測定したところ、88±1℃である。又、流入部、流出部、及び交差部の各温度は89±0.5℃であり、精度以温度制御が可能である。

(実施例3)

図 8 に示すように、第一の支持体 2 に厚さ 1 8 μ m の 銅を表面に有する銅張積層板(板厚0.2mm)を用い、 その表面に、第一の接着剤層1a及び第二の接着剤層1 bとして、室温で非粘着性接着剤であるダウコーニング アジア社製 S 9 0 0 9 (厚さ 2 0 0 μ m) をロールラミ ネートする。これに超音波振動と荷重の出力制御が可能 でNC制御でX-Yテーブルを可動できるマルチワイヤ 用布線機を用い、仁礼工業株式会社の高機能エンプラチ ューブ (材質: P E E K 、内径 0 . 2 m m 、外形 0 . 4 mm)を敷設する。敷設する中空フィラメント58には、 荷重80gと周波数30kHzの超音波による振動をか ける。中空フィラメント58の敷設は、半径5mmの円 弧状に行い、交差する部分も設ける。その交差部の近傍 では、荷重と超音波振動を止めることとする。第二の支 持体6として、デュポン社製カプトン200Hの表面に ダウコーニングアジア社製S9009(厚さ200μ m)をロールラミネートしたものを用い、真空ラミネー トで中空フィラメント58を敷設した表面にラミネート する。

その後、中継部 8 となる箇所の第二の支持体 6 、第一の接着剤層 1 a、第二の接着剤層 1 b、及び中空フィラメント 5 8 に対して、プリント基板用の小径穴あけ用途のレーザ穴あけ機を用いパルス幅 5 m s、ショット数を4ショットで φ 0 . 2 m m の穴をあける。その後、ルー

ターで外形加工し、複数の流路が接続した中継部8を有するマイクロ流体システム用支持ユニットを作製できる。

(その他の実施例)

本発明は上記の形態によって記載したが、この開示の一部をなす部分及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施例、実施例及び運用技術が明らかとなろう。

例えば、図9Aに示すように、マイクロ流体システム 用支持ユニットの一部に貫通孔を設け、カム付きなかり、カム付きない。 の中空フィラメントを変形させるののかった。 がおるでは、マイクロバルブのような使い方のいののからは、中空フィラメント58に弾性があると良いのいる。 い下であることが好ましい。

又、図9Bに示すように、露出した中空フィラメント58の一部に金属膜59を形成し、電圧などを印加するための端子を形成することが出来る。この場合、Cu、A1、ニッケル(Ni)、クロム(Cr)、金(Au)、等を単層、或いは多層化してめっきや蒸着などで形成すると良い。

又、マイクロ流体システム用支持ユニットは、図8A, 図8Bに示すように、開口部である中継部8を備えてい たが、中継部 8 が流体の混合又は分岐のみを行う場合、 図 1 0 に示すように、第二の支持体 6 を除去加工しない で閉ざした構造にしても良い。

更に、第一の中空フィラメント群と第二の中空フィラメント群は必ずしも 9 0 度に直交している必要はなく、交差していれば良い。したがって、例えば、第一及び第二の中空フィラメント群だけでなく、更に第三の中空フィラメント群を敷設することも可能である。

一方、中空フィラメントは必ずしも交差させる必要はなく、図11及び図12に示すように、一方向に走行する複数の中空フィラメント501~508からなる第一の中空フィラメント群のみから構成しても良い。

又、図13に示すように、湾曲を描く複数の中空フィラメント511~518を敷設しても良い。

尚、中空フィラメントは、必ずしも複数敷設されていなくても良く、即ち中空フィラメントは単数であっても 良い。

産業上の利用可能性

以上のように、本発明によれば、製造が容易で、かつ 反応や分析の工程数や量を制限しないcm単位の長い距離のマイクロ流体システム用支持ユニットを提供することが出来る。

この結果、本発明によれば、精度が良く、かつ製造ばらつきが少ない流体回路(マイクロ流体システム)を提

供するとが出来る。更に、立体的に複数の中空フィ直をカトからなる第一の中空フィラメント群とこれで、立体的に複数の中空フィ直交で、カーの中空フィットがある。 東京の中空フィットを観光が出来る。 マイクロ流体システム用支持ユニットを精度している。 でいるのようなマイクロ流体システム用支持ユニットを精度している。 でいるのようなではらつきが少なく製造する方法を提供できる。

請求の範囲

1. 第一の支持体と、

該第一の支持体の表面に設けられた第一の接着剤層と、 該第一の接着剤層の表面に任意の形状に敷設されたマ イクロ流体システムの流路層として機能する中空フィラ メント

とを備えることを特徴とするマイクロ流体システム用 支持ユニット。

2. 第一の支持体と、

該第一の支持体の表面に設けられた第一の接着剤層と、 該第一の接着剤層の表面に任意の形状に敷設され、それぞれがマイクロ流体システムの複数の流路層として機 能する複数の中空フィラメントからなる第一の中空フィ

とを備えることを特徴とするマイクロ流体システム用 支持ユニット。

3. 前記第一の中空フィラメント群の表面に設けられた第二の接着剤層と、

該第二の接着剤層の表面に設けられた第二の支持体 とを更に備えることを特徴とする請求項 2 に記載のマ イクロ流体システム用支持ユニット。

4. 前記第一の中空フィラメント群に互いに交差する方向に敷設され、前記マイクロ流体システムの他の複数の流路層として機能する、複数の中空フィラメントからなる第二の中空フィラメント群を更に備えることを特徴と

ر وهنيه*

. する請求項2又は3に記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。

- 5. 前記複数の中空フィラメントの一部が、前記第一の支持体から露出していることを特徴とする請求項2~4のいずれか1項に記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。
- 6. 前記複数の中空フィラメントの少なくとも1本の一部に金属膜が形成されていることを特徴とする請求項2~5のいずれか1項に記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。
- 7. 前記複数の中空フィラメントの少なくとも1本の一部が、光透過部を備えることを特徴とする請求項2~6のいずれか1項に記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。
- 8. 第一の支持体と、

該第一の支持体の表面に設けられた第一の接着剤層と、 該第一の接着剤層の表面に敷設された複数の中空フィ ラメントと、

前記第一の接着剤層と前記中空フィラメント上に設けられた第二の接着剤層と、

該第二の接着剤層の表面に設けられた第二の支持体と、 前記第一の接着剤層と前記第二の接着剤層に設けられ、 前記中空フィラメントの経路を接続する中継部

とを備えることを特徴とするマイクロ流体システム用 支持ユニット。

- 9. 前記中継部は前記第二の支持体の一部を含むことを特徴とする請求項8に記載のマイクロ流体システム用支持ユニット。
 - 10. 第一の支持体の表面に、第一の接着剤層を形成するステップと、

該 第 一 の 接 着 剤 層 の 表 面 に 中 空 フィ ラ メ ン ト を 敷 設 する ステップ

とを含むことを特徴とするマイクロ流体システム用支 持ユニットの製造方法。

1 1 . 第一の支持体の表面に、第一の接着剤層を形成するステップと、

該第一の接着剤層の表面に複数の中空フィラメントからなる第一の中空フィラメント群を敷設するステップ

とを含むことを特徴とするマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法。

1 2. 前記第一の接着剤層を形成するステップと、前記第一の中空フィラメント群を敷設するステップとの間に、前記第一の接着剤層の表面の中空フィラメントを露出させる箇所に離形層を設けるステップと、

前記第一の支持体にスリットを設けるステップ

とを更に含み、前記第一の中空フィラメント群は前記一対の離形層の双方の表面に接して敷設されることを特徴とする請求項11に記載のマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法。

1 3. 前記第一の中空フィラメント群を敷設するステッ

プの後、前記第一の中空フィラメント群に交差する方向に複数の中空フィラメントからなる第二の中空フィラメント群を敷設するステップを更に含むことを特徴とする請求項11又は12に記載のマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法。

14. 前記第一の中空フィラメント群を敷設するステップの後、

前記第一の中空フィラメント群の表面に、第二の接着 剤層を形成するステップと、

該第二の接着剤層の表面に第二の支持体を接着するステップ

とを更に含むことを特徴とする請求項11又は12に 記載のマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法。 15. 第一の支持体の表面に、第一の接着剤層を形成す るステップと、

前記第一の接着剤層の表面に複数の中空フィラメントを敷設するステップと、

前記第一の接着剤層と前記中空フィラメント上に第二の接着剤層を形成するステップと、

前記第一の接着剤層及び前記第二の接着剤層に中継部を形成するステップと、

前記第二の接着剤層の表面に第二の支持体を接着するステップ

とを含むことを特徴とするマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法。

16.前記第一の接着剤層及び前記第二の前記接着剤層に中継部を形成するステップは、更に前記第二の支持体も前記中継部の一部となるように形成することを含むことを特徴とする請求項15に記載のマイクロ流体システム用支持ユニットの製造方法。

PCT/JP03/02066

1/12

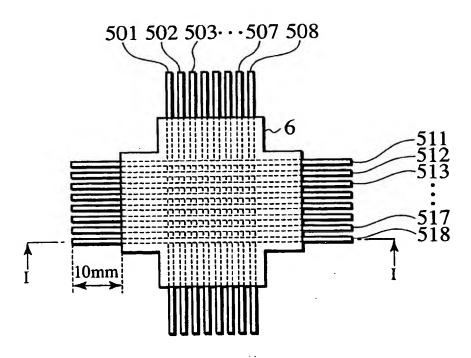
FIG. 1A

501 502 503 504 · · ·

518

10mm

FIG. 1B



2/12

FIG. 2

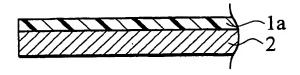


FIG. 3A

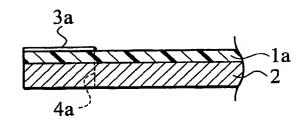
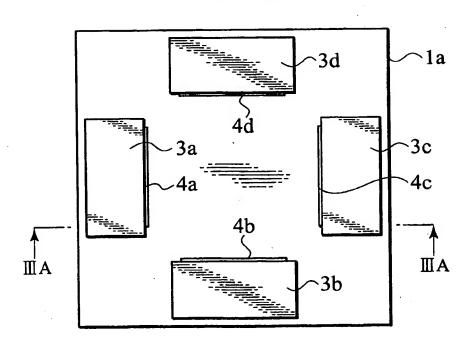


FIG. 3B



3/12

FIG. 4A

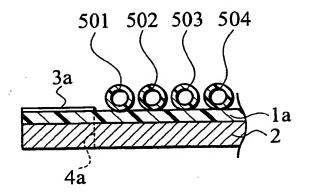


FIG. 4B

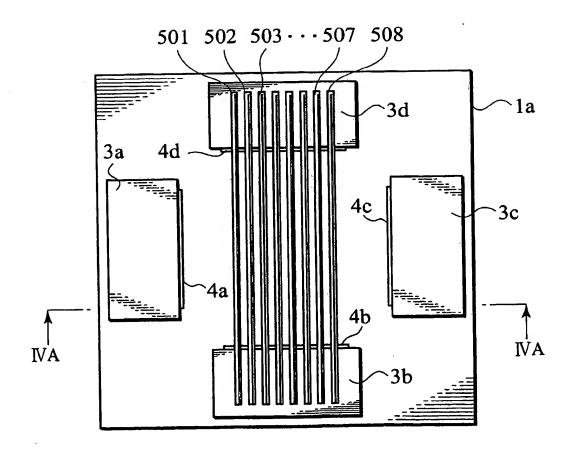


FIG. 5A

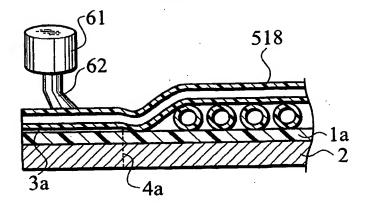
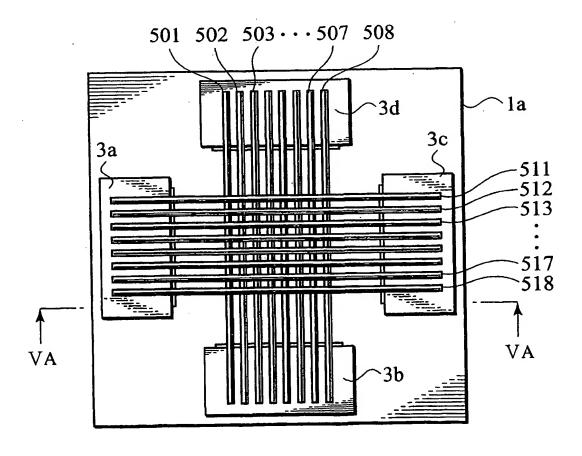


FIG. 5B



5/12

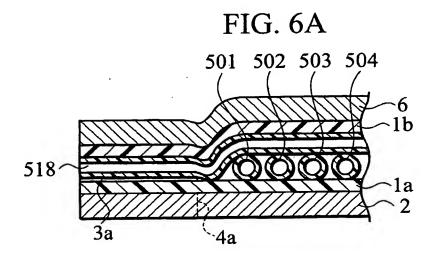
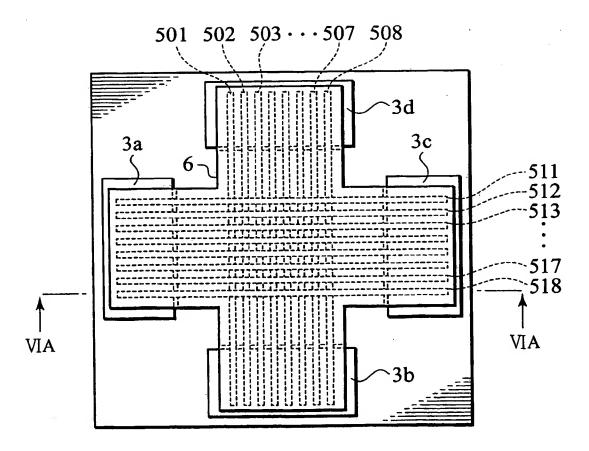


FIG. 6B



6/12

FIG. 7A

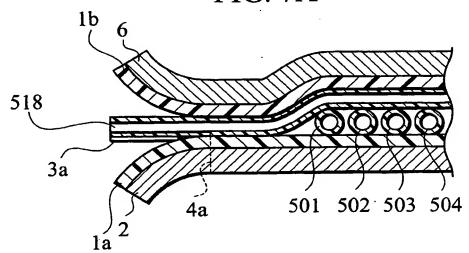
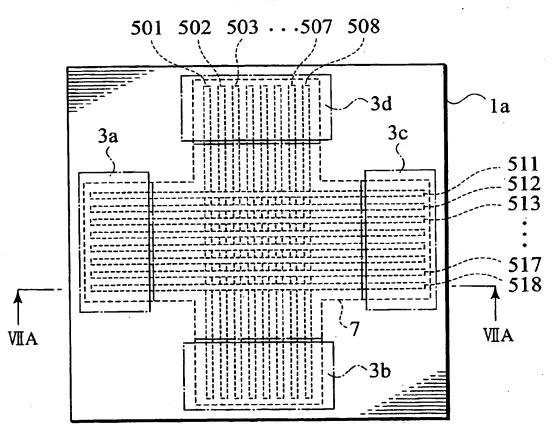


FIG. 7B



7/12

FIG. 8A

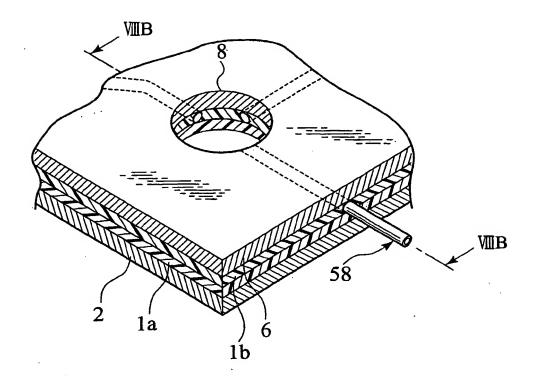
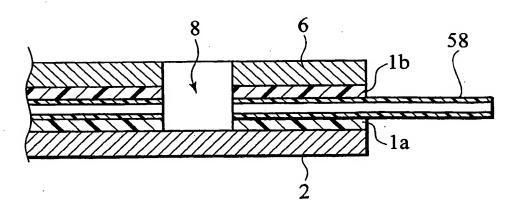


FIG. 8B



8/12

FIG. 9A

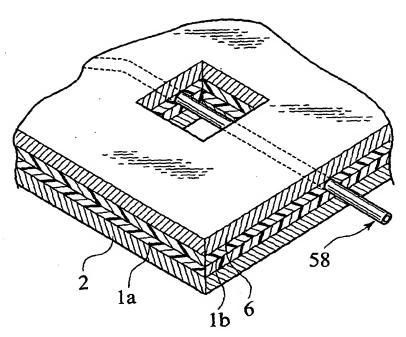
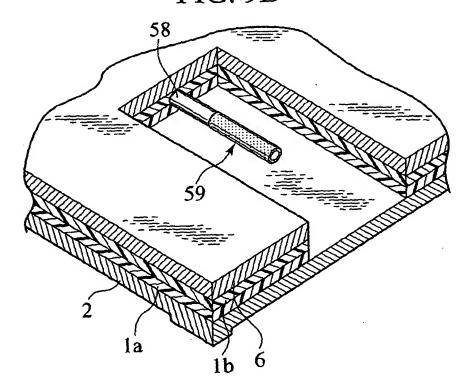
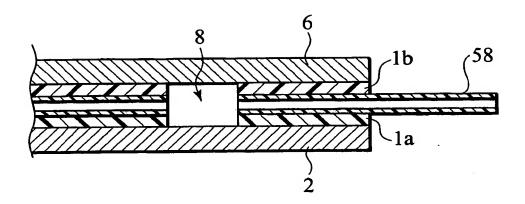


FIG. 9B



9/12

FIG. 10



PCT/JP03/02066

10/12

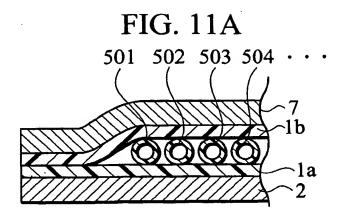


FIG. 11B

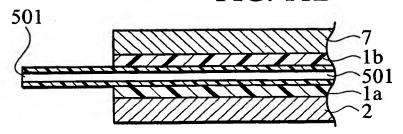
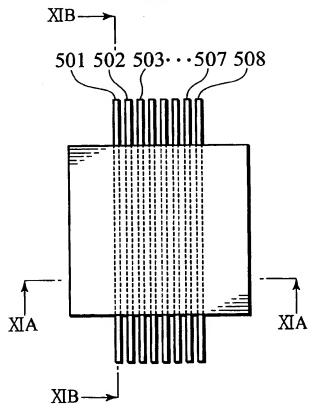


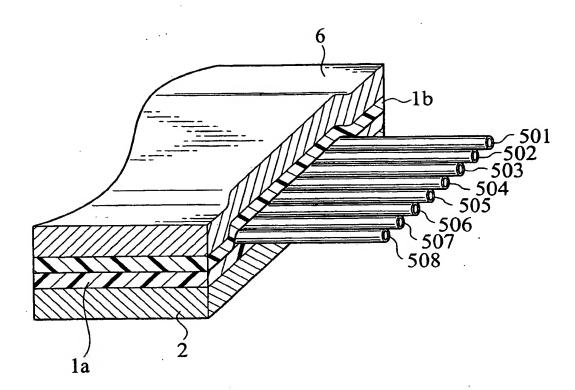
FIG. 11C

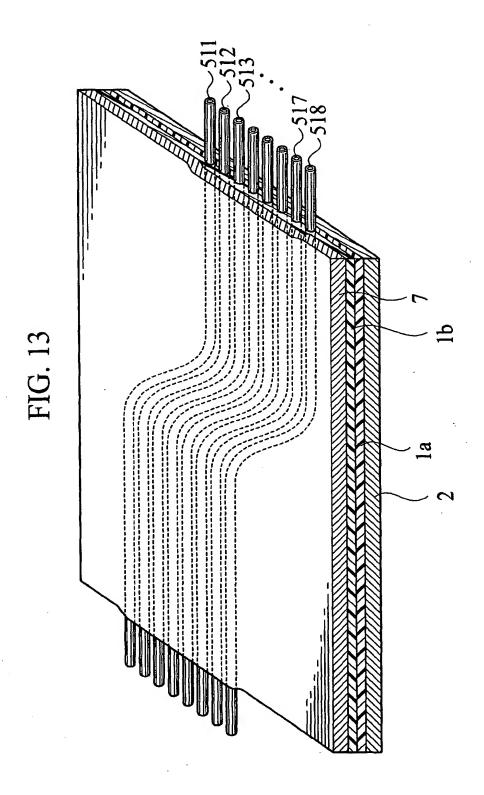


PCT/JP03/02066

11/12

FIG. 12





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP03/02066

A. CLASS	FICATION OF SUBJECT MATTER	/00 B01 T19/00			
Int.	Cl ⁷ B81B1/00, B81C5/00, G01N37,	700, B01019700			
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS	SEARCHED				
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed by C1 ⁷ B81B1/00, B81C5/00, G01N37,	y classification symbols) /00, B01J19/00			
1110.	,				
			in the fields searched		
Jitsu	ion searched other than minimum documentation to the tyo Shinan Koho 1926-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Kond) 1994-2003		
Kokai	Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003	Jitsuyo Shinan Toroku Koho			
Electronic d	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, sear	rch terms used)		
 	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Relevant to claim No.		
Category*	Citation of document, with indication, where app	graph And Telephone	1-7, 10, 11, 13,		
X	Corp.),	graph and rerephone	14		
A	21 January, 2000 (21.01.00), Claims; Fig. 1		8,9,12,15,16		
	(Family: none)				
x	WO 01/08802 A1 (MOLECULAR DY	NAMICS INC.),	1,2,5-7,10,		
	08 February, 2001 (08.02.01),	·	11 3,4,8,9,		
A	Claims; Fig. 3 & JP 2003-505711 A		12-16		
A	WO 99/41606 A1 (STICHTING VO	OR FUNDAMENTEEL	1-16		
"	ONDERZOEK DER MATERIE),				
	19 August, 1999 (19.08.99), Claims; Fig. 1				
	& JP 2002-503501 A				
	·				
	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	aired Cline data on		
"A" docum	al categories of cited documents: nent defining the general state of the art which is not	"I" later document published after the int	he application but cited to		
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot considered novel or cannot be considered to involve an invention					
date "I" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone			e claimed invention cannot be		
special reason (as specified) considered to involve an inventive			p when the document is hocuments, such		
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later document member of the same patent family					
than t	than the priority date claimed				
Date of the actual completion of the international search 02 June, 2003 (02.06.03) Date of mailing of the international search 17 June, 2003 (17.06.03)					
		Authorized officer			
Japanese Patent Office					
Facsimile No.		Telephone No.			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/02066

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 98/53046 A1 (EXCORP MEDICAL, INC.), 26 November, 1998 (26.11.98), Claims; Figs. 1 to 2 & JP 2000-515391 A	1-16
Ą	WO 00/16833 A1 (THE UNIVERSITY OF UTAH RESEARCH FOUNDATION), 30 March, 2000 (30.03.00), Claims; Figs. 1 to 2 § JP 2002-526273 A	1-16
		·

国際調査報告

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' B81B1/00, B81C5/00, G01N37/00, B01J19/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' B81B1/00, B81C5/00, G01N37/00, B01J19/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2003年

日本国登録実用新案公報

1994-2003年

日本国実用新案登録公報

1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
X A	JP 2000-19145 A (日本電信電話株式会社), 20 00.01.21,特許請求の範囲,第1図(ファミリーなし)	1-7,10,11,13,14 8,9,12,15,16		
X A	WO 01/08802 A1 (MOLECULAR DYNAMICS IN C.), 2001.02.08,特許請求の範囲,第3図 & JP 2003-505711 A	1,2,5-7,10,11 3,4,8,9,12-16		
A	WO 99/41606 A1 (STICHTING VOOR FUNDAMENT EEL ONDERZOEK DER MATERIE), 1999.08.19, 特許請求の範囲,第1図 & JP 2002-503501 A	1-16		

X C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

02.06.03

国際調査報告の発送日

17.06.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員) 高田 元樹



3C | 9821

電話番号 03-3581-1101 内線 3322

国際調査報告

C (続き).	関連すると認められる文献	関連する
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
A	WO 98/53046 A1 (EXCORP MEDICAL, INC.), 19 98.11.26, 特許請求の範囲,第1-2図 & JP 2000-515391 A	1-16
A	WO 00/16833 A1 (THE UNIVERSITY OF UTAH RESEARCH FOUNDATION), 2000.03.30, 特許請求の範囲, 第1-2図 & JP 2002-526273 A	1-16

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.